

使用产品

种植 - 氧化锆基台 - 桥 - 氧化物陶瓷 - 有固位型基台 - 后牙 - Multilink Speed

☐ Multilink Speed

自粘接自固化复合树脂水门汀，可选择性光固化



☐ OptraStick

有粘性和弹性工作头的粘接工具



☐ Telio CS Inlay

临时光固化充填材料用于制作临时嵌体以及种植修复螺丝通道的封闭



☐ OptraGate

保证术区相对隔离



☐ Ivoclean

Ivoclean通用型清洁糊剂，有效清洁试戴后产生的蛋白酶污染



☐ Liquid Strip阻氧剂

丙三醇凝胶,预防树脂类水门汀粘接修复体时氧阻聚层的形成



☐ OptraPol

OptraPol 是适用于市面上复合树脂材料打磨抛光的一步法优质抛光工具



☐ Cervitec Plus

口腔护理涂漆包含洗必泰和麝香草酚保护暴露的牙根面和控制细菌



流程图 Multilink Speed

种植 - 氧化锆基台 - 桥 - 氧化物陶瓷 - 有固位型基台 - 后牙 - Multilink Speed

1 术前处理



基台们螺丝固位.

2 修复体试戴



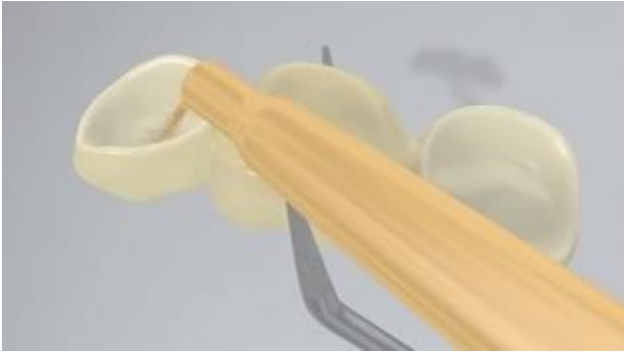
修复体试戴. 修复体颜色, 密合度和咬合的检查.

3 螺丝通道清洁并封闭好



水雾彻底冲洗螺丝通道并用无油气枪吹干. 随后, 螺丝通道封闭. 选用棉球或者泡沫颗粒和 **Telio CS Inlay** 临时嵌体树脂. 进一步后续治疗, 隔离术区, e.g. 使用 **OptraGate**, 是不可缺少的. 可选择性放置排龈线.

4 修复体预处理



修复体粘接面喷砂(e.g. **IPS e.max ZirCAD**, 1 bar, Al_2O_3 100 μm 或遵照生产商说明书).

5 Multilink Speed的使用



Multilink Speed注射器自动混合包装，混合后可以直接注射到修复体粘接面.

6 修复体就位后去除溢出的水门汀



修复体就位，轻加压力保持不动.



溢出的水门汀用光固化灯固化 (e.g. **Bluephase N**, 650 mW/cm^2 , LOW mode)1秒短固化quarter技术 (近远中颊舌面)距离光导棒工作头0-10 mm.



溢出的材料呈啫喱状用种植刮治器械容易去除



像所有树脂类材料, **Multilink Speed**遇氧气抑制固化.为了避免这个问题, 建议在修复体的边缘覆盖氧隔绝剂 (e.g Liquid Strip) 去除溢出水门汀后马上使用 .



随后光固化水门汀边缘20秒 (e.g. **Bluephase N** 高光强模式, approx. 1,200 mW/cm²). 遮色好透光差的材料,可以自固化.



氧隔绝剂水冲净. 并且需要把OptraGate开口器,隔湿棉,排龈线去除.

7 修复体完成



邻面的调整抛光. 如有必要进行咬合的调整. 修复体边缘抛光 (OptraPol) 抛光头或抛光碟.

8 随诊



一薄层 **Cervitec Plus** 使用毛刷涂抹于需要的位置. 吹干后涂料形成一层薄膜.